

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-08-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	广大保德信 陈飞达；银华基金 郭磊；交银施罗德 高扬、杨茉然、孙婕衍；招商基金 王若擎；宝盈基金 张天闻；华商基金 童立；国泰基金 张阳；中融基金 汤祺；平安养老 蓝逸翔；中邮人寿 鲍淼；招商局资本 彭映雪；钦沐资产 吴海宁；西部利得基金 邢毅哲、陈蒙；上投摩根 黄进；大摩华鑫 李子扬；国信证券 胡剑、胡慧；中海基金 曹煜狄；万家基金 傅一特；诺安基金 陈衍鹏；中信建投证券 徐博；华富基金 王帅；上海明河投资 姜宇帆；湘财基金 刘生；中银基金 王寒、尹苓；国寿安保 张标；招商资产 吴彤；南方基金 章晖；诺德基金 王优草；红土创新基金 黄雪雨；国信分公司 王华俊、李敏；上海盘京投资 王莉；深圳市新同方投资 杨涛；深圳市景泰利丰投资 吕伟志；泰康资产 李晓金；浙商证券 蒋高振；方正证券 陈杭、吴文吉。
时间	2021年8月26日
地点	中晶科技会议室电话会议方式召开
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司情况介绍 公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品为半导体单晶硅棒及半导体单晶硅片。公司产品主要应用于半导体分立器件和集成电路，是专业的高品质半导体硅材料

制造商。公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，在半导体硅材料制造领域拥有多项核心技术与专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料的研发与生产，在研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和强大的技术创新能力。在我国分立器件用硅研磨片领域占据领先的市场地位。最终产品应用在各种电子产品当中，包括消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等领域。

二、互动交流

1、公司未来的产业布局如何？

公司未来会形成三大业务板块：

(1) 研磨硅片板块：研磨硅片业务是公司主营业务，也是当前主要利润来源，公司当前产品在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位。未来公司将会在巩固现有基础上，继续扩大产能；

(2) 抛光片板块：募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》含抛光片产品，工艺按照 8 英寸正片的要求设置。目前进展顺利，基础设施建设、公共动力设施、管道安装、设备到货等按照整体规划在加速推进中；

(3) 芯片板块：公司 8 月对外投资设立合资公司，即江苏皋鑫电子有限公司，主营业务是高压硅堆等分立器件制造。公司通过整合提升，未来会进一步扩大产能和营收。

2、为什么公司产能增加，上半年的硅棒对外销量没有明显增加？

公司半导体硅棒业务一直处于满产满销的状态，由于公司后道工序硅片产能的持续扩大，硅棒供应紧张，硅棒优先供应内部需求，所以外销增量不明显。

3、请简要介绍一下上半年的两个收购项目？

公司今年上半年完成两项收购：

第一项是资产收购。收购宁夏隆基部分土地、厂房、机器设备，设备改造升级后逐步投入使用，硅棒的产量将在未来一段时间内逐步释放。浙江公司持续开展硅片产能的扩产工作，宁夏公司、浙江公司产线相互配合，产能将会进一步释放。

第二项是设立新公司，实现芯片项目布局。中晶科技以自有资金出资，以货币形式出资 10,200 万元，占江苏皋鑫电子有限公司注册资本 51%；南通皋鑫以其机器设备、无形资产、存货、货币出资占 30%；两家投资公司分别占比 7%、12%。本次合资公司设立后，将拓展中晶科技的现有业务及技术，推动公司研发水平与创新能力发展，提升可持续发展能力和核心竞争力，进一步增强公司的综合实力，合资公司的成立符合公司经营发展战略。

4、公司上半年的毛利又有提高，公司维持毛利持续上升的原因是什么？

公司产品毛利率稳步提升的原因，主要有以下几方面：

(1) 公司建有行业最大规模的磁场单晶生长炉台，以及硅片加工和测试工艺制程，生产能力和技术水平处于领先地位，规模效应提高了产品利用率，从而提高产品的经济效益；

(2) 生产基地的资源有效划分配置，根据各个子公司所处的优势进行产业配置，有针对性的开展相应业务，既有效利用各地资源，也节约了生产成本；

(3) 通过提高产品良率、改进生产工艺、加强设备自动化改造、增加技术研发投入等方式，不断提高产品生产效率及质量水平；

(4) 公司经营注重时间成本和原料储备等因素的有效控制，细节把控各项因素对公司生产经营的影响。

	<p>5、公司未来的发展规划如何？是否还会向其他领域进军？</p> <p>公司未来将在巩固现有行业地位的前提下，密切关注行业发展趋势和客户需求，进一步完善半导体硅材料产品结构，提升公司创新能力和核心竞争力，加强与产业链的合作，不断提高公司产品的市场占有率。</p> <p>6、公司上市以来，收购资产、买新设备、设新公司，这一些列举措下来，公司资金压力是否严重，后续是否会考虑增发需求？</p> <p>公司会根据未来的发展规划、资金情况等因素适时考虑增发计划。</p> <p>7、公司往下游拓展有何优势？是否存在技术等方面的难度？</p> <p>公司的优势主要体现在以下几个方面：</p> <p>（1）原材料优势：公司已有产品可以为下游市场提供充足的原材料供应，往下游发展只是将原有产品工艺往后道延伸；</p> <p>（2）技术优势：公司的合作方南通皋鑫有 52 年的行业经验，并积累了丰富的技术经验和专利水平，曾荣获中华人民共和国国家质量奖；</p> <p>（2）资金优势：中晶科技在深交所主板上市，有效拓宽了项目的融资渠道，为公司未来发展提供动力；</p> <p>（3）团队优势：公司的管理、生产、技术研发团队具备良好的专业背景和 20 多年本行业从业经历，在企业管理、工艺优化、设备改造、产品更新与开发等方面拥有丰富的专业知识和实践经验。</p> <p>新公司目前正处于设立过程中，未来将会在技术研发、市场拓展等方面面临一定的困难。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2021 年 8 月 26 日
----	-----------------